



tok 中期計画2015

(2014年3月期～2016年3月期)

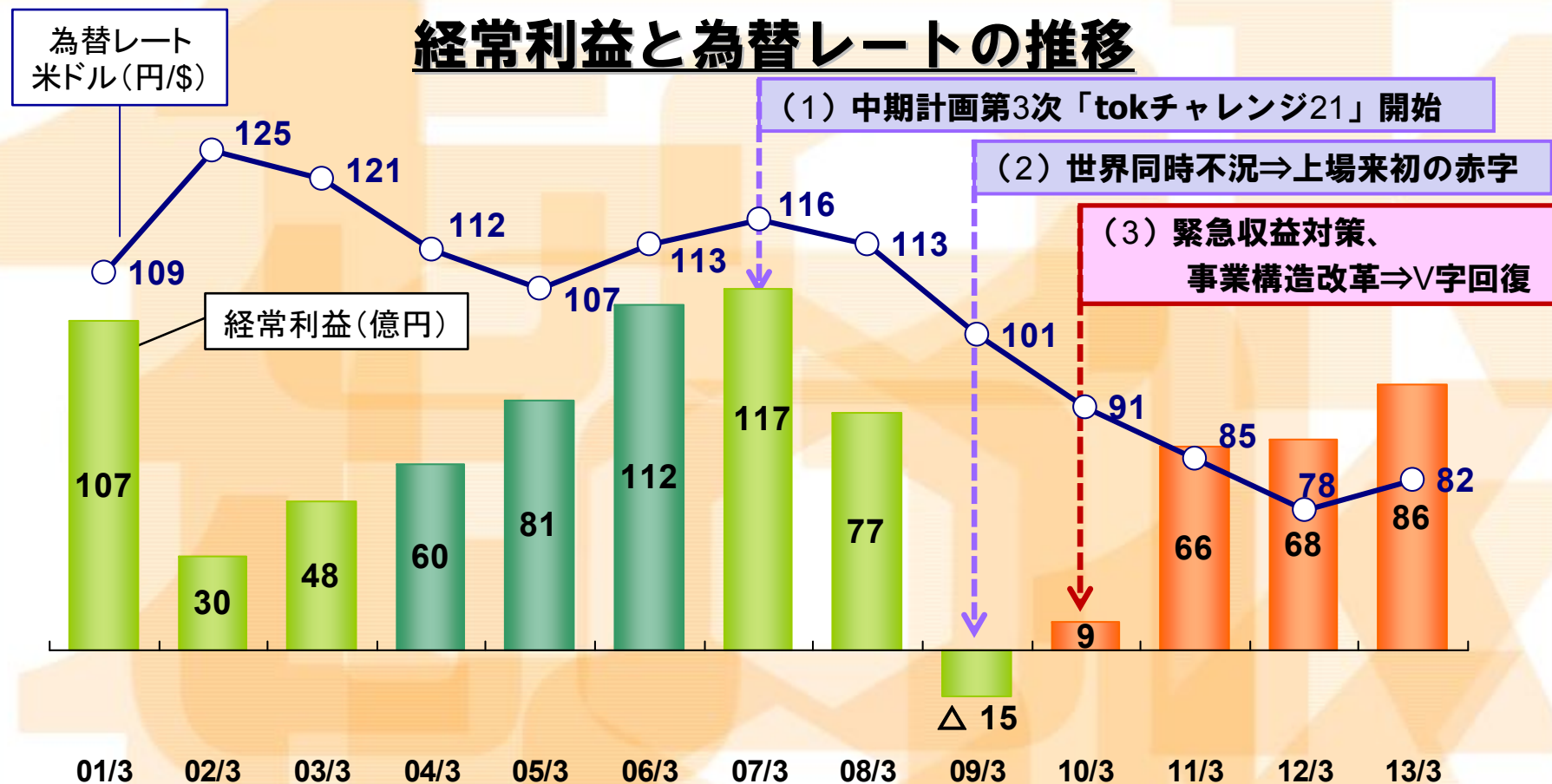
2013年5月9日

目次

■ 業績レビュー・成果	p.2～p.3
■ tok中期計画2015	p.4～p.15
● 数値目標・数値計画	・・・p.4
● 経営ビジョン・経営目標	・・・p.6
● 重点戦略	・・・p.7
● 高密度実装材料・新規材料	・・・p.10
● 設備投資・減価償却	・・・p.15
■ tokグループの目指す将来像に向けて	p.16

1-1.業績レビュー

経常利益と為替レートの推移



2000年以降（2001/3期以降）のピーク経常利益は117億円

2013/3期：歴史的円高の中、経常利益86億円を確保

1-2.事業構造改革後の成果

新・中期計画の業績を牽引する“鍵”

- 『筋肉質の体質』への転換完了
 - DFR生産からの撤退、印刷事業譲渡
 - 損益分岐点売上高の改善（単体：2009/3期比約40%低下）
- 半導体用フォトレジストの事業基盤増強
 - ArFの市場シェア上昇、これに伴う収益拡大
- 既存技術の多用途展開による売上拡大
 - レジスト材料、MEMS材料、イメージセンサー材料
- TSV技術の蓄積、顧客とのリレーション強化
 - 2011/3期よりTSV装置の受注を開始

2-1.tok中期計画2015：数値目標

収益力を強化、収益拡大の瞬発力を増強

(百万円)	2013/3	2016/3	CAGR
売上高	72,919	99,000	+10.7%
営業利益	7,872	15,000	+24.0%
経常利益	8,617	15,000	+20.3%
当期純利益	5,443	11,000	+26.4%
為替(米ドル/円)	81.9	92.0	—

**中計
2015
特徴**

- (1) **過去最高益の更新** (*)
- (2) **持続的成長の基礎となる事業基盤の増強**
- (3) **再生可能エネルギー分野等への事業領域拡張**

2-2.事業別・部門別の数値計画

(百万円)

	2013/3	2016/3	CAGR
売 上 高	72,919	99,000	+10.7%
材 料 事 業	67,697	88,000	+9.1%
エレクトロニクス機能材料	43,116	62,300	+13.1%
高純度化学薬品	24,144	25,500	+1.8%
そ の 他	435	200	—
装 置 事 業	5,222	11,000	+28.2%
営 業 利 益	7,872	15,000	+24.0%
材 料 事 業	10,716	16,800	+16.2%
装 置 事 業	232	1,500	+86.2%
消 去 又 は 全 社	△3,075	△3,300	—

2-3.経営ビジョン・経営目標

■ 経営ビジョン

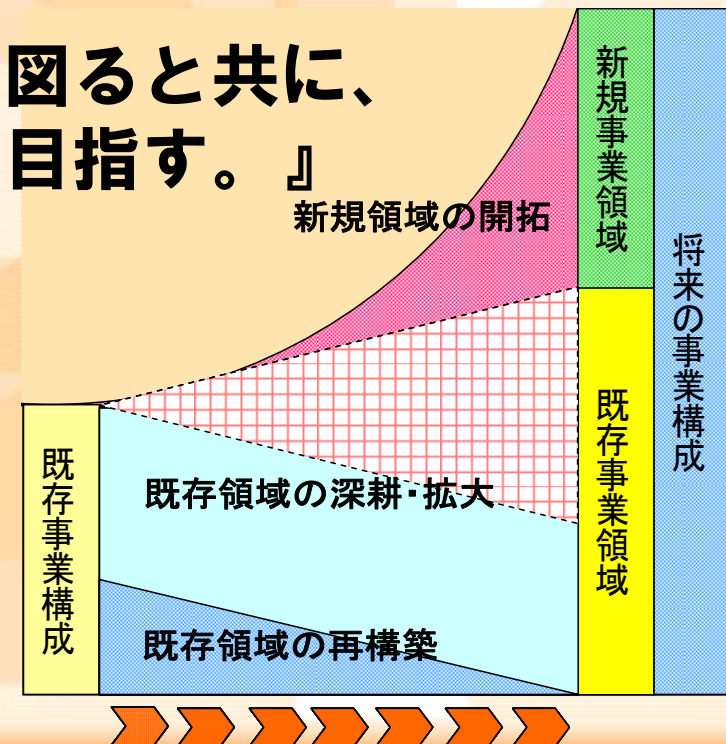
- 『高付加価値製品による感動を通じて、世界で信頼される企業グループを目指す。』
- 連結営業利益：200億円（2020年度目標）

■ 経営目標

- 『既存領域の深耕・拡大を図ると共に、新規領域の早期立ち上げを目指す。』

■ 全社戦略

- 各地域のユーザーとの密着戦略
- 事業ポートフォリオの変革
- グローバル人材の開発



2-4.重点戦略：収益強化ドライバー

- **半導体用フォトレジストの成長持続**
 - ArFの成長をベースとした事業成長
- **先端実装プロセス関連材料のビジネス獲得**
 - 半導体実装材料の新規市場へのフォーカス
 - MEMSユーザーへの新規材料拡販
- **タブレット・スマホ用高精細パネル関連の需要獲得によるLCD材料の拡大**
 - 顧客基盤拡充等によるシェアアップ

2-4.重点戦略：収益強化ドライバー

- 既存技術の**多角的展開**の継続、売上貢献
 - イメージセンサー材料、S i 系太陽電池関連材料等
- **装置事業**の収益回復、TSV装置の事業本格化
 - 2.5D、3D-IC試作ラインへのアプローチ
 - 海外現地対応の増強

2-5.重点戦略：事業ポテンシャル強化

■ ArF（1X）の開発強化、シェア確保

- 2016年量産本格化を想定
- W/Wベースシェア30%超

■ 次世代剥離液の開発

- 2017/3期以降の量産に向けた対応

■ 再生可能エネルギー分野等の新規材料開発

- 太陽電池関連、二次電池関連、太陽熱発電関連等
- 開発加速による早期上市（2015/3期～）

■ オプトエレクトロニクス分野への進出

3-1.高密度実装材料：市場の成長性

市場拡大が期待されるアプリケーション

スマートフォン

タブレットPC

コンピュータ
サーバ

ゲーム機

画像表示能力

画像処理能力

高速通信対応

処理速度

低消費電力

長時間駆動



競争力のあるデバイスの開発、プロセスの開発

3次元IC・2.5次元インターポザー・3次元TSV

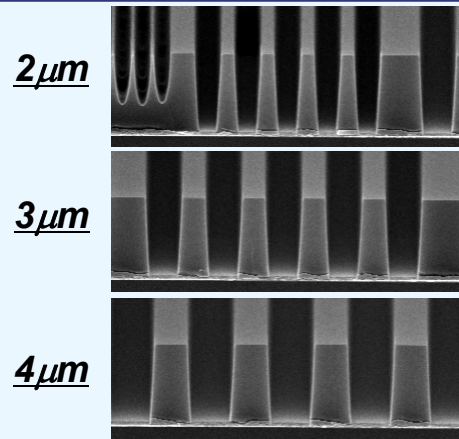


- 先端実装技術による半導体パッケージの量産拡大
- 新規プロセスに対するニーズ、新市場の創出
- 先端実装プロセス関連材料のビジネス拡大

3-2.tokの実装材料

先端パッケージ用 **ポジ型高解像レジスト** も展開

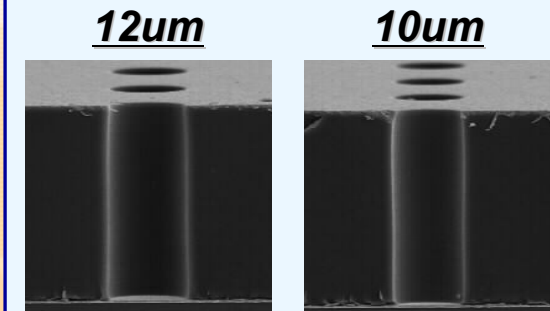
例) RDL (再配線層) 用材料



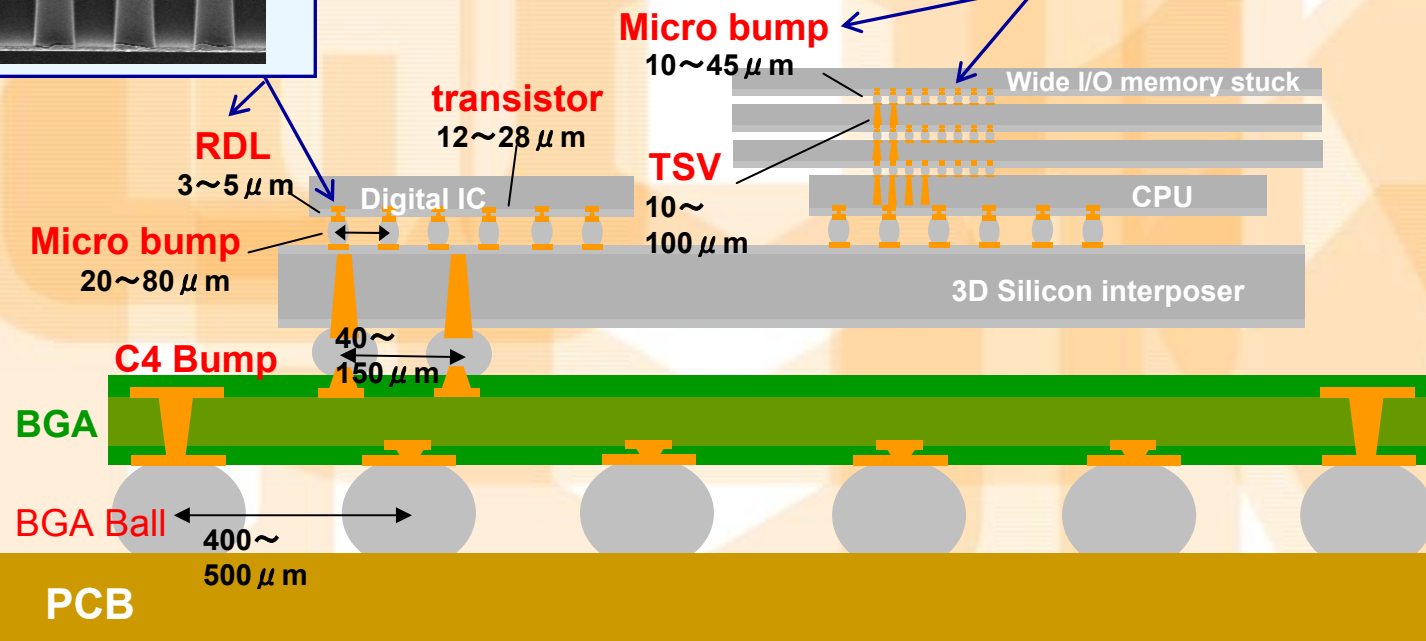
当社材料の使用箇所

- μ バンプ (Au、ソルダー)
- Cuピラー
- Auバンプ
- ソルダバンプ

例) Micro bump用材料



バンプの種類と大きさ



4-1.新規材料開発

『新規領域の早期立ち上げ』に向けた中核戦略

新事業開発室によるテーマ探索
⇒新規材料の開発、育成、事業化
活動方針

- コア技術(ナノ・リソ技術／高純度ケミカル製造)の多角的展開
- 外部機関等とのコラボレーション、アライアンスの活用
- M&E(材料＋装置)＋ソリューションによる新たな価値創製



■ 継続探索テーマ

再生可能
エネルギー

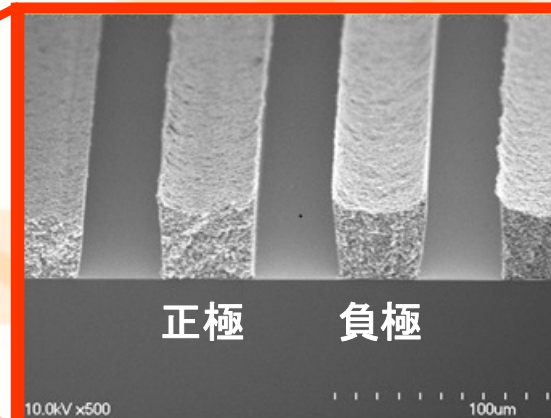
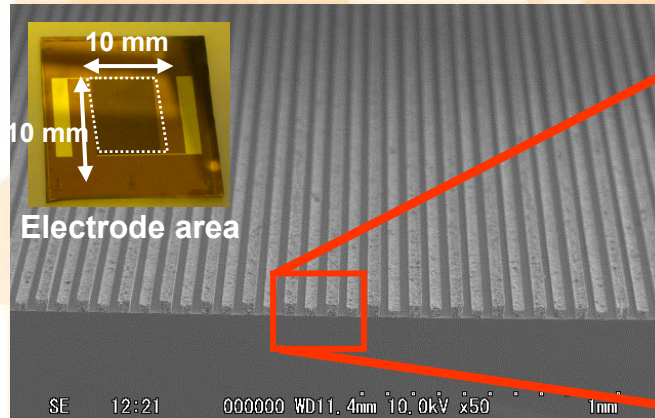
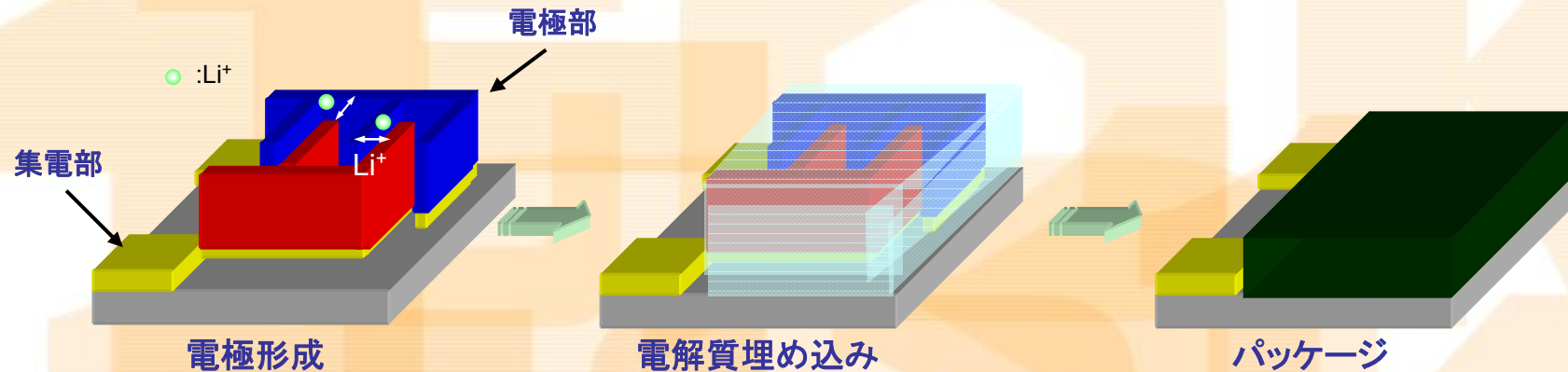
リチウム
イオン電池

オプト
エレクトロニクス

ライフ
サイエンス

4-2. マイクロ二次電池材料

■ tokのマイクロ二次電池材料



ワイヤレスセンサーネットワーク分野での需要に期待

4-3.OLED照明材料

デザイン性・インテリア性に優れるOLED照明

⇒ 今後の市場拡大への期待



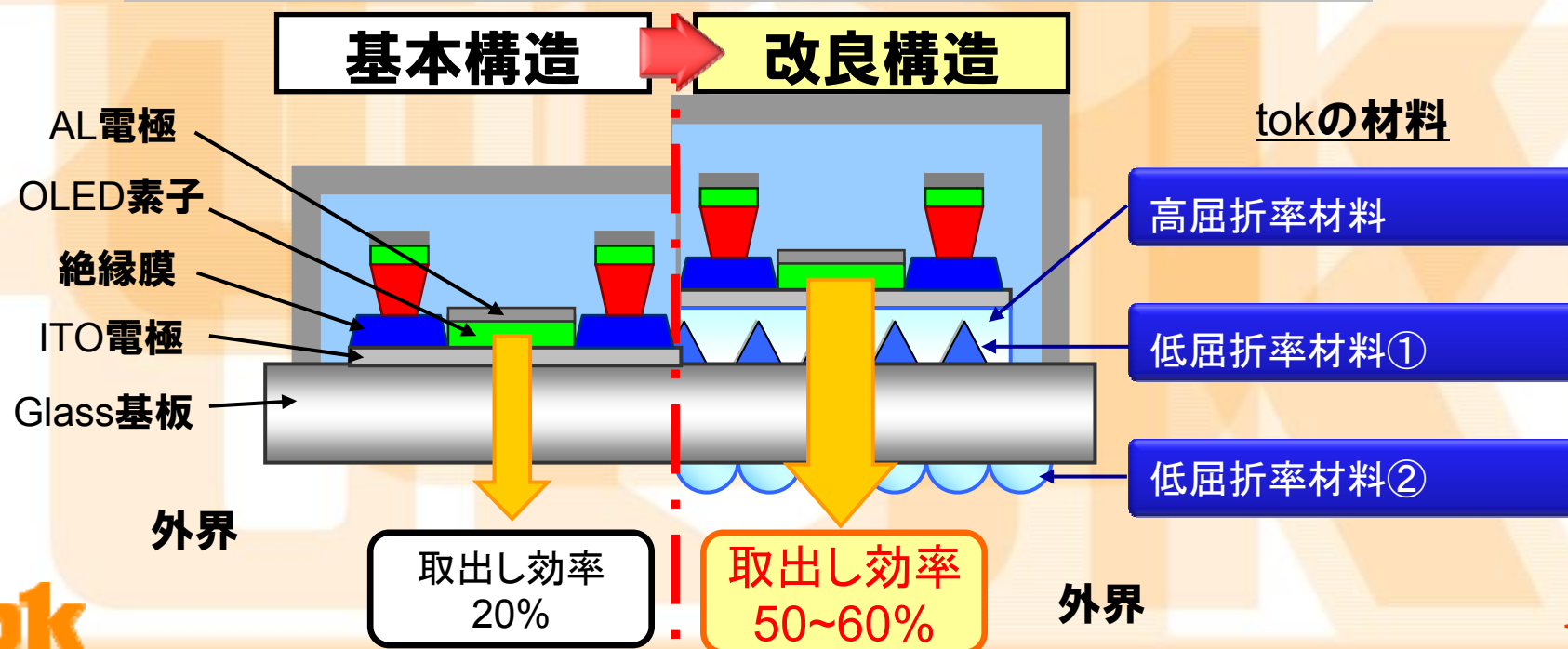
OLED照明
の課題

発光効率の向上

長寿命化

高歩留りの
製造プロセス開発

発光効率の向上に寄与するtokのOLED材料



5.設備投資・研究開発

(百万円、%)

期間累計	2011/3～ 2013/3	2014/3～ 2016/3	増減 (累計比較)
設備投資額	10,195	33,500	+23,304
減価償却費	12,190	17,000	+4,809
研究開発費	18,729	22,500	+3,770

(注)3ヵ年累計金額。2014/3期より減価償却方法を定率法から定額法に変更。

tokグループの目指す将来像に向けて

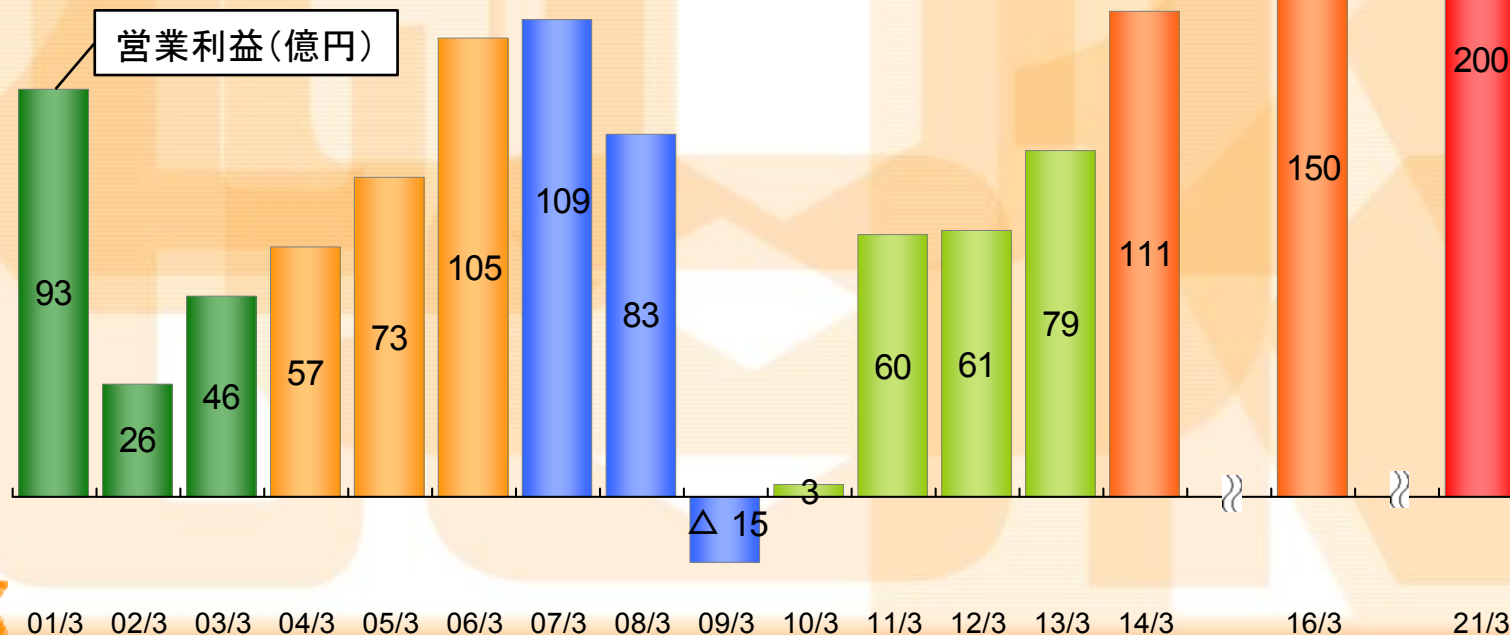
経営 ビジョン

『高付加価値製品による感動を通じて、
世界で信頼される企業グループを目指す。』

- 既存領域の深耕・拡大
- 新規領域の早期立ち上げ

2016/3

過去最高益の更新



<http://www.tok.co.jp/>

（ご注意）

本資料の業績予想は、現時点において見積もられた見通しであり、これまでに入手可能な情報から得られた判断に基づいております。したがって、実際の業績は、様々な要因やリスクによりこの業績予想とは大きく異なる結果となる可能性があります、いかなる確約や保証を行うものではありません。